

# 2022年度(2023年3月期)の取り組みのポイント

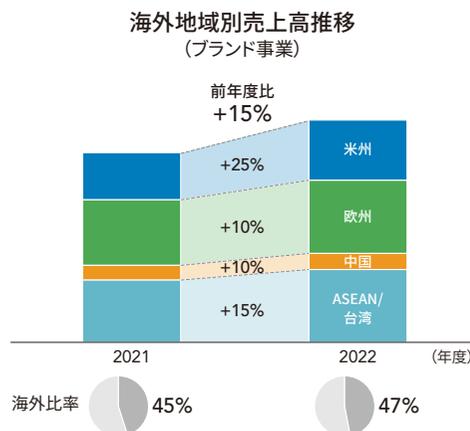


最新の決算情報は、下記にてご覧いただけます。  
<https://corporate.jp.sharp/ir/library/financial/>

## 1 海外事業の強化

2022年度については、米州・欧州・ASEAN/台湾を中心に事業伸長を見込んでおり、海外全体では前年度比約15%の成長を目指します。

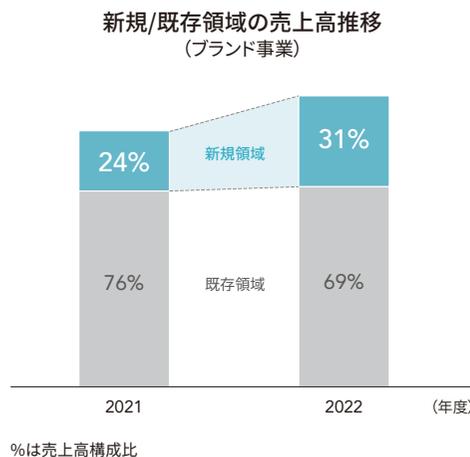
特に、米州と欧州では、ビジネスソリューション事業の着実な回復が見込まれる8Kエコシステムが成長を牽引し、ASEAN/台湾では、白物家電事業を含むスマートライフが事業拡大に貢献する計画となっています。



## 2 新規領域の拡大

シャープでは、既存事業を維持・強化しつつ、新規領域の売上構成比を拡大することで、事業全体の成長を図ります。

具体的には、「AIoT対応機器やAQUOS XLEDなどの新商品/サービスの開発」「海外事業やECチャネルなどの新市場の開拓」「ソリューション事業や異業種協業による新規B2B事業などの新規事業の創出」の3つに取り組みます。



## 3 リスクへの対応

足もと、「半導体不足及び高騰」「原材料や部材の不足及び高騰」「物流の混乱」など、サプライチェーンの混乱が大きなリスクとなっていますが、引き続き影響の最小化を図るべく取り組んでいきます。

「半導体不足及び高騰」では、メモリの需給バランスが落ち着きつつあるなど、やや改善傾向にあるものの、厳しい状況であることに変わりはないことから、半導体企業とのトップ交渉や調達先の多様化/代替品への切り替えなどの対策を行っています。

「原材料や部材の不足及び高騰」については、鋼材価格が高止まりし、電子部品では基板の価格が上昇傾向にあるなど、継続もしくは悪化の傾向にある中、調達先の多様化/代替品への切り替え、設計変更による不足/高騰部品の回避などに取り組んでいます。

また、「物流の混乱」についても、物流関係会社との連携による柔軟な対応などにより影響の最小化を図ります。

	概況	推進中の対策	2022年度影響度 (前年度からの変化)
半導体の不足/高騰	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリは落ち着いた需給バランスになりつつある</li> <li>その他は逼迫状態/値上げ基調が継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体企業とのトップ交渉</li> <li>調達先の多様化/代替品への切替</li> <li>ロングタームでのフォーキャストの提示</li> </ul>	改善傾向
原材料/部材の不足/高騰	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼材/銅/樹脂価格が高止まり。ロシアに対する各国の制裁措置により、同国産鉱物資源への影響が懸念</li> <li>電子部品は基板などの価格が上昇傾向。供給面ではコンデンサを中心に逼迫した状況が継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調達先の多様化/代替品への切替</li> <li>設計変更による不足/高騰部品の回避</li> <li>部材メーカーとの緊密な連携による問題の早期発見</li> </ul>	継続～悪化
物流の混乱	<ul style="list-style-type: none"> <li>米国各港は、上海ロックダウンに伴う物量減少により混雑が一時的に解消傾向。但し、今後はロックダウン解除に伴う物量増の本格化等により、再び混雑/運賃高騰が想定</li> <li>欧州各港は混雑が継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>物流関係会社SJL*との連携による状況変化に応じた速やかな配船やコストダウン</li> <li>物流ルートやコンテナの陸揚げ港の変更</li> </ul>	継続

※ シャープジャスタロジスティクス株式会社